

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005年8月4日 (04.08.2005)

PCT

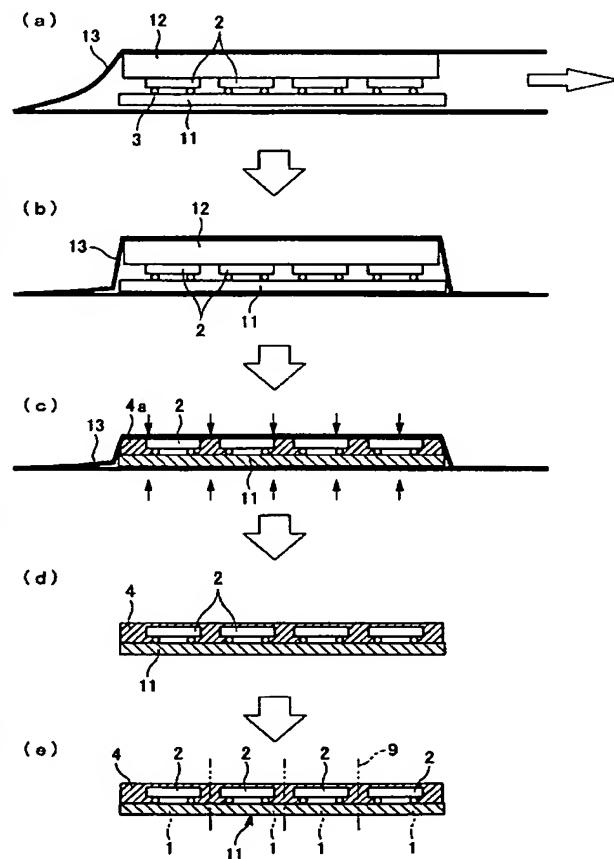
(10) 国際公開番号
WO 2005/071731 A1

- (51) 国際特許分類7: H01L 21/56
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/018211
- (22) 国際出願日: 2004年12月7日 (07.12.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2004-014492 2004年1月22日 (22.01.2004) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会社村田製作所 (MURATA MANUFACTURING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市東神足1丁目10番1号 Kyoto (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 日口 真人
- (HIGUCHI, Masato) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市東神足1丁目10番1号 株式会社村田製作所内 Kyoto (JP). 新開秀樹 (SHINKAI, Hideki) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市東神足1丁目10番1号 株式会社村田製作所内 Kyoto (JP). 石川修 (ISHIKAWA, Osamu) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市東神足1丁目10番1号 株式会社村田製作所内 Kyoto (JP).
- (74) 代理人: 宮崎▲主税, 外 (MIYAZAKI, Chikara et al.); 〒5400012 大阪府大阪市中央区谷町1丁目6番5号 西村ビル Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,

/ 続葉有

(54) Title: ELECTRONIC COMPONENT MANUFACTURING METHOD

(54) 発明の名称: 電子部品の製造方法



(57) Abstract: An electronic component manufacturing method in which few voids in the resin encapsulation portion are produced, degradation of the characteristics hardly occurs, and the cost can be reduced. The method includes a reduced-pressure packing step in which SAW devices (2) mounted on a mounting assembly board (11) and a resin film (12) are placed in a bag having gas-barrier capability (13) and the bag is sealed. The method further includes an encapsulating step in which the resin film (12) is made to enter the spaces among the SAW devices (2) mounted on the reduced-pressure-packed mounting assembly board (11) by using the pressure difference between the inside and outside of the bag (13), and thereby the SAW devices (2) are encapsulated with an encapsulating resin portion (4) derived from the resin film (12).

(57) 要約: 樹脂封止部分におけるボイドの発生及び経時的な特性劣化が生じ難く、低コスト化され得る電子部品の製造方法を提供する。実装集合基板11上に実装された各SAW素子2と樹脂フィルム12とを、ガスバリア性を備えた袋13の中に入れ、密封する減圧パック工程を設ける。減圧パックされた実装集合基板11上に実装された各SAW素子2間に樹脂フィルム12を袋13の内外の圧力差に基づき浸入させることにより、SAW素子2を樹脂フィルム12由来の封止樹脂部4によって封止する封止工程を設ける。

WO 2005/071731 A1



NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ヨーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。